

檔 號：

保存年限：

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路
5號

承辦人：蘇玫君

電話：02-7736-6164

電子信箱：sumc@mail.moe.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年3月9日

發文字號：臺教技(三)字第1120025130號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：國科會函、徵件DM 附件一 附件二

主旨：轉知國家科學及技術委員會辦理「2023台灣創新技術博覽會」之TIE Award徵件一案(如附件)，請查照。

說明：

- 一、依國家科學及技術委員會112年3月7日科會產字第1120013762號函辦理。
- 二、旨揭展會將於112年10月12日至10月14日於臺北世貿一館展出，請協助於所轄網站刊登活動資訊(宣傳文件下載連結：<https://reurl.cc/9VXapx>)。
- 三、旨揭競賽報名請自即日起至112年5月31日前，至TIE Award徵件網站完成線上報名(www.futuretech.org.tw)。
- 四、如有相關疑問，請逕洽本案聯絡窗高小姐，電話：(02) 2577-4249#844。

正本：各公私立大專校院(中州學校財團法人中州科技大學、和春技術學院、蘭陽技術學院、永達技術學院、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、高美醫護管理專科學校除外)

副本：國家科學及技術委員會